
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2020
(प्रथम संशोधन-2022)
(Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy -2020)
(First Amendment-2022)

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

अनुक्रमणिका

अध्याय 1 : परिचय	4
1.1 आमुख (Preamble)	4
अध्याय 2 : परिकल्पना, मिशन, लक्ष्य	4
2.1 परिकल्पना (Vision)	4
2.2 मिशन (Mission)	5
2.3 लक्ष्य (Target)	5
अध्याय 3 : शासन विधि (Governance)	5
3.1 नोडल संस्था (Nodal Agency)	5
3.2 नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU)	6
3.3 सशक्त समिति (EC)	6
अध्याय 4 : नीति का कार्यान्वयन	6
4.1 नीति की अवधि एवं आच्छादन (Policy period & Coverage)	6-7
4.2 नीति का प्रचार-प्रसार (Policy Promotion)	8
4.3 इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास (Infrastructure Development)	8
4.3.1 इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर्स (EMC)	8
4.3.2 इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन मैनुफैक्चरिंग (ESDM) पार्क	8
4.3.3 उत्कृष्टता के केन्द्र (CoE)	8
4.3.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों (MSME Units) को सहायता	9
4.3.5 अनुसंधान एवं विकास सहायता	9
4.4 ई-अपशिष्ट निस्तारण (e-Waste Handling)	9
अध्याय 5 : प्रोत्साहन	9
5.1 पूंजी उपादान	10
5.1(क) एंकर इकाई हेतु अतिरिक्त पूंजी उपादान	11
5.1(ख) फोकस क्षेत्र इकाइयों हेतु अतिरिक्त पूंजी उपादान	11
5.2 ब्याज उपादान	11
5.3 स्टाम्प ड्यूटी से छूट	12
5.4 पेटेन्ट्स लागत की प्रतिपूर्ति	12
5.5 भूमि हेतु प्राविधान	12
5.6 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट	13
5.7 कौशल विकास एवं अन्य सहायता	13
5.8 ई.एम.सी. विकास हेतु प्रोत्साहन	13
5.8.1 विकासकर्ताओं हेतु प्रोत्साहन	14
5.8.2 एकल इकाइयों हेतु प्रोत्साहन	14
5.9 प्राइवेट ई.एस.डी.एम. पार्क्स	15

5.10	सेमीकण्डक्टर इकाइयों के लिए फायदे	15
5.11	भविष्य निधि प्रतिपूर्ति	16
5.12	लीज रेन्टल्स	16
5.13	लॉजिस्टिक्स उपादान	16
अध्याय 6 :	अर्ह उत्पाद	16
अध्याय 7 :	शब्दावली	17
अध्याय 8 :	संक्षिप्त रूप	18
अनुलग्नक-1		19

अध्याय 1 : परिचय

1.1 आमुख (Preamble)

उत्तर प्रदेश की प्राचीन ऐतिहासिक भूमि, संसाधनों तथा सांस्कृतिक विरासत से अत्यन्त समृद्ध है। उत्तर प्रदेश, भारत के विशालतम राज्यों में से एक है जहाँ लगभग 200 बिलियन अमेरिकन डालर से अधिक सकल घरेलू उत्पाद तथा लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या सहित उपभोक्ताओं का विशालतम आधार है। त्वरित औद्योगीकरण, मेट्रो रेल, एक्सप्रेसवेज तथा भारत के पश्चिमी तट को उसके पूर्वी तट से जोड़ने वाला फ्रेट कॉरीडोर जोकि राज्य से होकर गुजरता है, आईटी सिटी, आईटी पार्क्स एवं इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर, इण्डस्ट्रियल जोन्स, प्रदेशव्यापी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, जेवर में एशिया के सबसे बड़े निर्माणाधीन विमानपत्तन तथा गौतमबुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित भारत के प्रथम इलेक्ट्रानिक्स सिटी इत्यादि जैसी राजकीय परियोजनाओं द्वारा प्रदेश ने तीव्रगति से विकास तथा विकसित समाज की ओर, पथ प्राप्त कर लिया है।

ओप्पो मोबाइल्स, हॉयर इलेक्ट्रानिक्स, टीसीएस, आईबीएम, विप्रो, एसटी माइक्रोइलेक्ट्रानिक्स इत्यादि जैसी कम्पनियों की उपस्थिति के साथ सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर का राज्य के उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान है तथा सैमसंग, एलजी इलेक्ट्रानिक्स, एचसीएल की दीर्घकालीन स्थापना और दो दशकों के अधिक समय से प्रदेश में उनका सफल कार्य-परिचालन प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। प्रदेश में कुशल जनशक्ति का प्रचुर भण्डार तथा उद्योगों की माँग को पूरा करने के लिए आई.आई.टी., आई.आई.एम., आई.आई.टी. इत्यादि प्रतिष्ठित संस्थान विद्यमान हैं।

इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन मैनुफैक्चरिंग इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए 'उपरो इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति' पूरे प्रदेश को आच्छादित करती है और नीति के अन्तर्गत समस्त प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश में अपना आधार स्थापित करने वाली सभी इकाइयों के लिए प्रभावी होंगे।

यह ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना में कई गुना वृद्धि के प्रति उत्प्रेरक होंगी जो न केवल अर्थ-व्यवस्था को बढ़ावा देगी, अपितु राज्य में बड़ी संख्या में रोजगार भी उत्पन्न करेंगी।

अध्याय 2 : परिकल्पना, मिशन, लक्ष्य

2.1 परिकल्पना (Vision)

नवप्रवर्तन और नवीन प्रौद्योगिकी के अनुकूल कुशल जनशक्ति के प्रभावी उपयोग द्वारा इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग को उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण विकास माध्यम के

रूप में विकसित किया जाना एवं इसके द्वारा चहुँमुखी चिरस्थायी परितंत्र (sustainable ecosystem) का सृजन तथा प्रदेश और देश की समग्र अर्थव्यवस्था में योगदान हेतु विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्द्धी बुनियादी ढाँचा और इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग के पुष्पित-पल्लवित होने के लिए अनुकूल नीतिगत परिवेश प्रदान करके उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक पसन्दीदा गन्तव्य स्थल के रूप में स्थापित किया जाना।

2.2 मिशन (Mission)

- (i.) इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक पसन्दीदा गन्तव्य स्थल के रूप में स्थापित किया जाना।
- (ii.) ई.एस.डी.एम. उद्योग के लिए राज्य में एक विश्वस्तरीय ईकोसिस्टम का निर्माण किया जाना।
- (iii.) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अर्थव्यवस्था के विकास माध्यम के रूप में विकसित किया जाना।
- (iv.) अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमिता की संस्कृति का पोषण।
- (v.) उद्योग के हितार्थ उच्च गुणवत्तायुक्त सेक्टर-स्पेसिफिक प्रतिभा का पूल बनाया जाना।

2.3 लक्ष्य (Target)

- (i.) रु 40,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना।
- (ii.) प्रदेश में तीन (3) इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) की स्थापना।
- (iii.) प्रदेश में तीन (3) उत्कृष्टता के केन्द्रों (CoE) की स्थापना।
- (iv.) प्रदेश में घरेलू/विदेशी निवेशकों द्वारा ई.एस.डी.एम. पार्क्स की स्थापना।
- (v.) फ़ैब इकाइयों के माध्यम से सेमीकण्डक्टर्स निर्माण में निवेश आकर्षित करना।
- (vi.) रोजगार के लगभग 4 लाख अवसर राज्य में ही प्रदान करना।

अध्याय 3 : शासन-विधि (Governance)

3.1 नोडल संस्था (Nodal Agency)

उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के अधीन एक नोडल संस्था नामित की जाएगी। यह संस्था राज्य में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण ईकोसिस्टम के सतत विकास हेतु एक नीतिगत वातावरण के सृजन हेतु उत्तरदायी होगी। यह ईकोसिस्टम के सभी हितधारकों के साथ सम्पर्क हेतु एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगी। एकल खिड़की परिचालन के प्रबन्धन हेतु नोडल संस्था सरकार को सहयोग प्रदान करने के लिए आउटसोर्स प्रोफेशनल्स और कन्सल्टेण्ट्स तथा पर्याप्त स्टाफ सहित एक समर्पित परियोजना प्रबन्धन इकाई (पी.एम.यू.) का गठन करेगी।

3.2 नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU)

नोडल संस्था के कार्यों की देख-रेख के लिए प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई स्थापित की जायेगी। नीति कार्यान्वयन इकाई निवेश प्रस्तावों के अनुमोदन, प्रोत्साहनों के संवितरण, सशक्त समिति को अपनी संस्तुति सहित नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी। नीति कार्यान्वयन इकाई रु 200 करोड़ से कम पूँजी निवेश वाले निवेश प्रस्तावों के परीक्षण एवं नीतिगत ढाँचे के अन्तर्गत उनके अनुमोदन हेतु उत्तरदायी होगी। तथापि रु 200 करोड़ से अधिक सम्भावित निवेश वाले प्रस्तावों को आवश्यक अनुमोदन हेतु सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

3.3 सशक्त समिति (EC)

इलेक्ट्रानिक्स नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति (Empowered Committee) स्थापित की जायेगी। समिति का अधिकार-पत्र (Charter) नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा सभी स्तरों पर निवेशकों से सम्बन्धित मुद्दों के सामयिक समाधान हेतु अन्तर्विभागीय सामन्जस्य से सम्बन्धित होगा। रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाएँ सशक्त समिति की अनुशंसा पर राज्य के मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन अधीन होंगी।

इस समिति में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, वित्त, नियोजन, लघु उद्योग, वाणिज्य कर, ऊर्जा, सिंचाई, आवास विभाग, श्रम तथा आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव के अतिरिक्त औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे।

अध्याय 4 : नीति का कार्यान्वयन (Policy Implementation)

4.1 नीति की अवधि एवं आच्छादन (Policy period & coverage)

उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 उसकी अधिसूचना तिथि से 5 (पांच) वर्षों के लिए वैध है।

निवेश की अनुमति नीति की अधिसूचना की तिथि से दी जायेगी। इकाई को व्यवसायिक रूप से परिचालनरत करने के लिए दिया जाने वाला समय निम्नानुसार होगा:-

- (i) रु 200 करोड़ तक निवेश: लेटर ऑफ कम्फर्ट की तिथि से 5 वर्ष
- (ii) रु 200 करोड़ से अधिक तथा रु 1000 करोड़ से कम निवेश: लेटर ऑफ कम्फर्ट की तिथि से 6 वर्ष
- (iii) रु 1000 करोड़ से अधिक अथवा समतुल्य निवेश: लेटर ऑफ कम्फर्ट की तिथि से 7 वर्ष

नीति प्रयोज्यता:

- (i) ऐसे निवेशक जिन्होंने उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत आवेदन किया और उन्हें विधिवत् लेटर ऑफ कम्फर्ट प्राप्त हुआ किन्तु 31 मार्च 2022 तक परियोजना का व्यवसायीकरण नहीं कर सके, उन्हें वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ करने के लिए 31 मार्च 2022 से अतिरिक्त 12 माह का विस्तार प्रदान किया जायेगा।
- (ii) ऐसे निवेशक जिन्होंने उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया किन्तु स्टाम्प ड्यूटी छूट, भूमि दर में छूट, विद्युत शुल्क आदि कोई एक अथवा अधिक प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के साथ ही 31 मार्च 2022 तक परियोजना का व्यवसायीकरण कर लिया है, उन्हें उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त कर लिये गये प्रोत्साहनों के लिए ही स्वीकार्य माना जायेगा तथा वे अन्य किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे।
- (iii) जिन निवेशकों ने स्टाम्प ड्यूटी छूट, भूमि दर में छूट, विद्युत शुल्क आदि कोई एक अथवा अधिक प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त किया है, किन्तु ना तो उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत आवेदन किया और ना ही 31 मार्च 2022 तक परियोजना का व्यवसायीकरण कर सके, उन्हें उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त कर लिये गये प्रोत्साहनों के लिए ही स्वीकार्य माना जायेगा तथा वे अन्य किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे। ऐसे निवेशकों को वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ करने के लिए 31 मार्च 2022 के बाद 12 माह का अतिरिक्त विस्तार प्रदान किया जायेगा। यदि निवेशक ने नीति के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया है अथवा 31 मार्च 2023 तक वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ कर पाने में असमर्थ है तो उसके द्वारा प्राप्त किये गये सभी लाभ की वसूली शासन/ प्राधिकरण के नियमानुसार की जायेगी।
- (iv) नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन नई इकाइयों के लिए लागू हैं। तथापि क्षमता विस्तार/ विविधीकरण/ प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए आवेदन करने वाली इकाइयां केवल पूंजी उपादान के लिए इस प्रतिबन्ध सहित पात्र होंगी कि क्षमता विस्तार/ विविधीकरण/ प्रौद्योगिकी उन्नयन के फलस्वरूप सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि हो।
 - (क) पिछली किसी भी नीति के अन्तर्गत पहले से ही विद्युत शुल्क का लाभ प्राप्त करने वाले निवेशक, बढ़े हुए भार पर भी स्वीकृत कार्यकाल तक शेष विद्युत शुल्क लाभ के लिए पात्र होंगे।
 - (ख) विस्तार/ विविधीकरण/ प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु आवेदन करने वाली नई इकाइयों के लिए कोई विद्युत शुल्क छूट उपलब्ध नहीं होगी।

नीति अवधि के विस्तार पर निर्णय नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति द्वारा लिया जायेगा।

उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अन्तर्गत प्राप्त निवेश प्रस्ताव जिन्हें इस संशोधन की अधिसूचना से पूर्व लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत नहीं किये गये हैं, वे संशोधित उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अन्तर्गत प्रदत्त लाभों के लिए पात्र होंगे।

4.2 नीति का प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन (Policy promotion)

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर नीति के प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन हेतु एक विपणन एवं ब्रॉडिंग रणनीति निर्धारित की जाएगी। नोडल संस्था द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे:-

- (i.) राज्य के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा उसकी नीतियों एवं विभिन्न प्रोत्साहनों की एक ब्रॉण्ड छवि का सृजन
- (ii.) नीति के प्रचार-प्रसार हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सभायें, रोड शो तथा इवेन्ट्स का आयोजन एवं उनमें प्रतिभाग करना।
- (iii.) राज्य में ई.एस.डी.एम. उद्योगों हेतु विद्यमान आकर्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया का उपयोग किया जाना।
- (iv.) प्रचार-प्रसार एवं निवेश प्रस्तावों की प्रोसेसिंग के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल का प्रबन्धन करना।

4.3 इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास (Infrastructure Development)

4.3.1 इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC)

इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर, कतिपय न्यूनतम सीमा के साथ वरीयतानुसार एक दूसरे से मिला हुआ एक भौगोलिक क्षेत्र है, जहाँ ई.एस.डी.एम. इकाइयों के लिए बुनियादी ढाँचे, एमेनिटीज तथा अन्य सामान्य सुविधाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। यह नीति मोबाइल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, ड्रोन, सेमीकण्डक्टर (फैब), चिकित्सा इलेक्ट्रानिक्स, रक्षा इलेक्ट्रानिक्स, रोबोटिक्स, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादि के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों में तीन (3) इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना को परिलक्षित करती है।

4.3.2 इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन मैनुफैक्चरिंग (ESDM) पार्क्स

पूरे प्रदेश में राजकीय/निजी संस्थानों के सहयोग से ई.एस.डी.एम. पार्क्स की स्थापना की जायेगी। घरेलू एवं साथ ही विदेशी निवेशकों के लिए ई.एस.डी.एम. पार्क्स के विकास को बढ़ावा दिया जाना नीति का उद्देश्य है। ई.एस.डी.एम. पार्क के विकास हेतु न्यूनतम 25 एकड़ भू-क्षेत्र की आवश्यकता है।

4.3.3 उत्कृष्टता के केन्द्र (CoE)

नीति का प्रयास ई.एस.डी.एम. क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के केन्द्रों (CoE) के रूप में विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित किया जाना है। नीति के अन्तर्गत प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों और/अथवा उद्योग संघों/उद्योग अथवा किसी अन्य शासकीय/निजी संस्थान के सहयोग से राज्य में उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है। उत्कृष्टता के केन्द्र की कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक (रु 10 लाख की सीमा सहित) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

उत्कृष्टता के केन्द्र की स्थापना को स्वीकृति प्रदान करने हेतु सशक्त समिति सक्षम होगी।

4.3.4 सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (MSME) इकाइयों को इन्फ्रास्ट्रक्चर सहायता

प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों क्षेत्र में स्वयं अथवा पी.पी.पी. मॉडल पर औद्योगिक कार्यबल के निवास हेतु किराये के लिए डॉरमिटरीज के विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रदेश सरकार द्वारा प्लग एण्ड प्ले मॉडल पर ई.एस. डी.एम. इकाइयों की स्थापना हेतु निवेशकों के लिए स्वयं अथवा पी.पी.पी. मॉडल पर रेन्टल सुविधाओं के विकास को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। निजी क्षेत्रों को भी इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण इकाइयों के लिए डॉरमिटरीज तथा प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं का निर्माण कर उन्हें किराये पर दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4.3.5 अनुसंधान एवं विकास सहायता

सरकार द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) / वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों को समर्थन प्रदान किया जायेगा।

- वित्तीय सहायता प्रतिपूर्ति के रूप में (पूँजी और परिचालन व्यय को सम्मिलित करते हुए) परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक, 5 वर्ष की अवधि में अधिकतम रु 5.00 करोड़ तक।
- पात्र प्रतिपूर्ति राशि का 50 प्रतिशत वार्षिक आधार पर प्रदान किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि उत्पाद/शोध एवं विकास गतिविधियों के सफल विकास के उपरान्त संवितरित की जायेगी।

4.4 ई-अपशिष्ट निस्तारण (e-Waste Handling)

नीति के अन्तर्गत वैश्विक प्रथाओं के अनुसार खतरनाक पदार्थों के उपयोग पर प्रबन्धन सहित ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन और हैण्डलिंग) नियम 2011 के क्रियान्वयन की सुविधा के लिए उद्योगों के साथ एक तन्त्र के विकास को प्रोत्साहन दिया जायेगा। राज्य में उत्पन्न ई-अपशिष्ट के लिए राज्य में ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण कम्पनियों (रि-साइकिलिंग इकाइयों) को भी प्रोत्साहन दिया जायेगा। ई-अपशिष्ट उत्पाद भारत सरकार की ई-वेस्ट नीति के अनुसार आच्छादित होंगे।

अध्याय 5 : प्रोत्साहन (Incentives)

इस नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों से पृथक और उनके अतिरिक्त हैं। तथापि किसी भी इकाई को भारत सरकार से प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों को सम्मिलित करते हुए, समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाले वित्तीय प्रोत्साहन, जब तक कि नीति में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इकाई के स्थिर पूँजी

निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार की पीएलआई योजना के अन्तर्गत लाभ को, स्थिर पूँजी निवेश के 100 प्रतिशत की सीमा के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नीति के अन्तर्गत अनुमन्य समस्त प्रोत्साहन व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ किये जाने के उपरान्त ही प्रदान किये जायेंगे।

राज्य में इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों के पुनः निर्माण, मरम्मत अथवा नवीनीकरण के लिए इकाई स्थापित करने वाले निवेशक नीति के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले सभी प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे।

स्थिर पूँजी निवेश (FCI) के अन्तर्गत भवन, संयंत्र एवं उपकरण/मशीनरी जैसे पूँजीगत निवेश एवं परिसम्पत्तियाँ सम्मिलित हैं। स्थिर पूँजी निवेश के आगणन हेतु निम्नलिखित को सम्मिलित किया जायेगा:—

- (i.) स्थिर पूँजी निवेश के आगणन हेतु भूमि के मूल्य को शामिल नहीं किया जायेगा।
- (ii.) इकाई के स्थिर पूँजी निवेश के आगणन हेतु भवन के लागत की सीमा कुल स्थिर पूँजी निवेश का अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।
- (iii.) पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की अनुमति स्थिर पूँजी निवेश के 40 प्रतिशत तक होगी। इस प्रोत्साहन हेतु केवल उन इकाइयों को अनुमति होगी, जिनका मूल्यांकन पुनर्निर्मित संयंत्र और मशीनरी सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया हो और यह विकल्प इस नीति की अधिसूचना की तिथि से प्रथम 20 निवेशकों के लिए ही उपलब्ध होगा।

5.1 पूँजी उपादान

पूँजी उपादान पात्र इकाइयों को प्रदान किया जायेगा तथा वित्तीय संस्थानों/बैंकों/वित्तीय परामर्शदाताओं द्वारा अथवा राज्य सरकार के माध्यम से गठित समिति द्वारा मूल्यांकित स्थिर पूँजी निवेश पर अनुमन्य होगा। निवेशक निम्नानुसार प्रोत्साहनों के पात्र होंगे:—

- (i) **रु0 200 करोड़ तक के निवेश :** निवेशक को स्थिर पूँजी निवेश पर 15 प्रतिशत पूँजी उपादान प्रदान किया जायेगा।
- (ii) **रु0 200 करोड़ से अधिक तथा रु 1000 करोड़ से कम निवेश:** निवेशक को स्थिर पूँजी निवेश का 15 प्रतिशत पूँजी उपादान 03 वार्षिक किशतों में प्रदान किया जाएगा जोकि व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ करने के उपरान्त देय होगा।
- (iii) **रु0 1000 करोड़ से अधिक अथवा समतुल्य निवेश:** रु 1000 करोड़ से अधिक स्थिर पूँजी निवेश तथा न्यूनतम 3000 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन पर 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पूँजी उपादान अधिकतम रु0 100 करोड़ (कुल रु 250 करोड़) प्रदान किया जायेगा। यह अतिरिक्त उपादान 05 वार्षिक किशतों में प्रदान किया जायेगा जिसमें से प्रथम

किश्त उस वर्ष अवमुक्त की जायेगी जिसमें इकाई ने अपनी कुल क्षमता का न्यूनतम 80प्रतिशत उत्पादन अर्जित कर ली हो।

अभ्युक्ति: प्लग एण्ड प्ले/किराए के भवनों से संचालित होने वाली इकाइयों के लिए पूंजी उपादान 5 वार्षिक किश्तों में दिया जाएगा, जो वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के बाद देय होगा।

5.1 (क) एंकर इकाई हेतु अतिरिक्त पूंजी उपादान

एंकर इकाई के रूप में कार्य करने वाले तथा पूरक इकाइयों को साथ लाने की गारण्टी देने वाले निवेशक को अतिरिक्त पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा। प्रोत्साहन राशि का भुगतान सभी प्रस्तावित सहायक इकाइयों की सफल स्थापना के बाद किया जायेगा।

- (i) 1 से 5 इकाइयों – अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत
- (ii) 6 से 10 इकाइयों – अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत
- (iii) 10 से अधिक इकाइयों – अतिरिक्त 5 प्रतिशत

यह अतिरिक्त पूंजी उपादान नीति के प्रस्तर 5.1 में उल्लिखित पूंजी उपादान के अतिरिक्त होगा। एंकर इकाई द्वारा अपनी कच्चे माल की आवश्यकता का न्यूनतम 40 प्रतिशत उन पूरक इकाइयों से क़य किया जाना चाहिए जिनका प्रस्ताव इस मद के अन्तर्गत लाभ प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। साथ ही इस लाभ को प्राप्त करने वाली इकाइयां फोकस क्षेत्र के प्राविधान द्वारा अतिरिक्त पूंजी उपादान के लिए पात्र नहीं होंगी।

5.1 (ख) फोकस क्षेत्र इकाइयों हेतु अतिरिक्त पूंजी उपादान:

निम्नलिखित फोकस क्षेत्रों के तहत आवेदन करने वाले निवेशक को 5 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा।

- ड्रोन और उसके कम्पोनेन्ट्स
- इन्टरनेट ऑफ थिंग्स
- रक्षा इलेक्ट्रानिक्स
- सामरिक इलेक्ट्रानिक्स
- रोबोटिक्स

इस लाभ को प्राप्त करने वाली इकाइयों एंकर इकाई के लिए प्राविधानित अतिरिक्त पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी।

5.2 ब्याज उपादान

रु 200 करोड़ तक निवेश वाली इकाइयों हेतु अधिसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर (ब्याज की दर पर) 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष हेतु प्रतिवर्ष रु 1 करोड़ की सीमा तक (अधिकतम रु 7 करोड़ प्रति इकाई) की जायेगी।

5.3 स्टाम्प ड्यूटी से छूट

- (i) एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि का क्रय करने/पट्टे पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।
- (ii) ई.एम.सी./ ई.एस.डी.एम. पार्क्स हेतु भूमि का क्रय करने/पट्टे पर लेने पर प्रथम ट्रॉजेक्शन (स्वामी से विकासकर्ता/एस.पी.वी.) हेतु स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट तथा द्वितीय ट्रॉजेक्शन (विकासकर्ता/एस.पी.वी. से ई.एस.डी.एम. इकाइयों) पर स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।
- (iii) स्टाम्प शुल्क में छूट बैंक गारण्टी के सापेक्ष प्रदान की जायेगी, जिसे वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर अवमुक्त कर दिया जायेगा।
- (iv) न्यूनतम 10 वर्षों के लिए भूमि/ औद्योगिक शेड/ औद्योगिक भवन पट्टे/किराये पर लेने पर 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।
- (v) स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर की जायेगी।

5.4 पेटेन्ट्स फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति

सफल घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रु 5,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 की सीमा तक पेटेन्ट फाइलिंग लागत की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जायेगी।

5.5 भूमि हेतु प्राविधान

- (i.) ई.एम.सी./ई.एस.डी.एम. पार्क्स की एस.पी.वी./पी.आई.ए. तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों को मध्योचल तथा पश्चिमोचल क्षेत्र में सरकारी अभिकरणों से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत भूमि उपादान प्रदान किया जाएगा।
- (ii.) ई.एम.सी./ई.एस.डी.एम. पार्क्स की एस.पी.वी./पी.आई.ए. तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों को बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र में सरकारी अभिकरणों से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 50 प्रतिशत भूमि उपादान प्रदान किया जाएगा।
- (iii.) उपरोक्त (i) व (ii) पर उल्लिखित भूमि उपादान निवेशकों को कुल परियोजना लागत के 7.5 प्रतिशत अथवा रु 75 करोड, जो भी कम हो, की सीमा तक, प्रदान किया जाएगा। इस उपादान का भुगतान राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित प्राधिकरण को निवेशक के द्वारा इकाई/ परियोजना के व्यवसायीकरण उपरान्त, नीति की अवधि में वास्तविक उपयोग के आधार पर विभिन्न चरणों में किया

जायेगा। प्राधिकरण द्वारा इस उपादान का समायोजन इकाई की भुगतान योजना के सापेक्ष किया जायेगा।

- (iv.) फ्लोर एरिया रेशियो.: इकाइयों को 3.0 + 1.0 (क्रय योग्य) फ्लोर एरिया रेशियो की अनुमन्यता होगी।
- (v.) कर्मकारों हेतु डॉरमिटरीज तथा कल्याणकारी सुविधायें: न्यूनतम 25 एकड़ भूमि क्षेत्र में "इण्डस्ट्रियल लैण्ड यूज" में 30 प्रतिशत के कुल फ्लोर एरिया रेशियो की सीमा तक भूमि का उपयोग कल्याणकारी सुविधाओं यथा कर्मकारों हेतु डॉरमिटरीज, कैण्टीन, डिस्पेन्सरी आदि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

5.6 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट

निवेशकों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट की अनुमन्यता निम्नानुसार 10 वर्षों के लिए होगी:-

- (i) पश्चिमोच्चल में परिचालनरत इकाइयों हेतु 50 प्रतिशत
- (ii) मध्योच्चल में परिचालनरत इकाइयों हेतु 75 प्रतिशत
- (iii) पूर्वाच्चल तथा बुन्देलखण्ड में परिचालनरत इकाइयों हेतु 100 प्रतिशत

संशोधित दरें इस संशोधन के उपरान्त नीति के अन्तर्गत स्वीकृत नए निवेश प्रस्तावों पर लागू होंगे। पूर्व स्वीकृत निवेश प्रस्तावों पर पूर्व में अनुमन्य 50 प्रतिशत की दर ही लागू होगी।

5.7 कौशल विकास एवं अन्य सहायता

- (i.) समस्त ई.एस.डी.एम. इकाइयों राज्य सरकार की अप्रेन्टिसशिप सहायता योजना के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रशिक्षण के दौरान भुगतान की गई स्टाइपेन्ड धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगी।
- (ii.) पात्र इकाइयों को योजना का लाभ दिये जाने हेतु उ0प्र0 कौशल विकास मिशन का अनुकूलन इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए आवश्यक कौशल सेट के साथ किया जायेगा।
- (iii.) इस उद्देश्य के लिए ई.एस.डी.एम. क्षेत्र में कौशल विकास को इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा आवंटित बजट के साथ संवर्द्धित किया जायेगा।
- (iv.) 24X7 परिचालन तथा सभी तीन पालियों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति प्रदान की जायेगी।

5.8 ई.एम.सी. विकास हेतु प्रोत्साहन

भारत सरकार की संशोधित इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) योजना के अन्तर्गत ई.एम.सी. परियोजनाओं में सामान्य सुविधाओं तथा अमेनिटीज के साथ बुनियादी ढाँचे के सृजन हेतु इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) स्थापित किये जायेंगे तथा ई.एस.डी.एम. क्षेत्र में निवेश आकृष्ट करने के लिए औद्योगिक आस्थानों/पार्क्स/क्षेत्रों में कॉमन फेसिलिटी सेन्टर्स (CFC)के रूप में बुनियादी ढाँचे को उच्चिकृत किया जायेगा। इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर तथा कॉमन फेसिलिटी सेन्टर्स दोनों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

5.8.1 विकासकर्ताओं हेतु प्रोत्साहन (Incentives for Developers)

- (i.) सड़कों, ऊर्जा, जलापूर्ति, परीक्षण सुविधाओं इत्यादि इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास पर निहित ई.एम.सी. लागत हेतु 50 प्रतिशत योगदान भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
- (ii.) ई.एम.सी. लागत के अवशेष 50 प्रतिशत हेतु परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण (PIA) तथा राज्य सरकार – प्रत्येक द्वारा 25 प्रतिशत योगदान किया जायेगा।
- (iii.) कॉमन फेसिलिटी सेन्टर (CFC) की विकास लागत का 25 प्रतिशत योगदान परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा किया जायेगा, जबकि उसका शेष 75 प्रतिशत योगदान भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
- (iv.) भूमि उपादान की अनुमन्यता नीति के प्रस्तर 5.5 के अनुसार होगी।

5.8.2 एकल इकाइयों हेतु प्रोत्साहन (Incentives for Individual Units)

- (i.) ऍकर इकाइयों की प्रतिबद्धता कम से कम 20 प्रतिशत बिक्री योग्य भूमि तथा न्यूनतम निवेश रु 300 करोड़ तथा अधिकतम निवेश रु 750 करोड़ होनी चाहिए।
- (ii.) ऍकर इकाइयों को उनके 20 प्रतिशत भू क्षेत्र में बिना सब-लीज अथवा हस्तान्तरण शुल्क के वेण्डर इकाइयों स्थापित किए जाने की अनुमति होगी।
- (iii.) ई.एम.सी. के विकास उपरान्त एस.पी.वी. से एकल इकाइयों के पक्ष में भूमि हस्तान्तरण पर सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा कोई फीस/शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा।

- (v.) यदि एस.पी.वी./पी.आई.ए. द्वारा पहले ही नीति की धारा 5.8.1 के अनुरूप, भूमि उपादान का लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो तो इकाइयों को भूमि उपादान की अनुमन्यता नीति के प्रस्तर 5.5 के अनुसार होगी।

5.9 प्राइवेट ई.एस.डी.एम. पार्क्स

- (i.) भूमि उपादान की अनुमन्यता नीति के प्रस्तर 5.5 के अनुसार होगी।
- (ii.) सम्बन्धित प्राधिकरण से सिंगिल विन्डो सहायता तथा प्रत्येक पार्क हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना।
- (iii.) प्रति पार्क 7 वर्षों तक रु 10 करोड़ प्रतिवर्ष तथा कुल रु 50 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित, वार्षिक ब्याज के 60 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के रूप में ब्याज उपादान।
- (iv.) भूमि के क्रय करने/पट्टे पर लेने पर, प्रथम ट्रांजेक्शन पर 100 प्रतिशत तथा द्वितीय ट्रांजेक्शन पर 50 प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी से छूट। स्टाम्प शुल्क में छूट बैंक गारण्टी के सापेक्ष प्रदान की जायेगी, जिसे वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर अवमुक्त कर दिया जायेगा।

5.10 सेमीकण्डक्टर इकाइयों के लिए फायदे

सेमीकण्डक्टर इकाइयों की स्थापना हेतु निवेश आकर्षित करने तथा राज्य की नीति में इलेक्ट्रानिक्स इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रस्तुत करके निवेशकों को प्रोत्साहित किया जायेगा:-

1. **पूंजी उपादान:** भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजी उपादान पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी उपादान
2. **भूमि की दर में छूट:**
 - (i) राज्य अभिकरणों से भूमि क्रय करने पर प्रथम 200 एकड़ भूमि पर प्रचलित सेक्टर दरों पर 75 प्रतिशत उपादान
 - (ii) इकाई के लिए अथवा पूरक इकाइयों के लिए अतिरिक्त भूमि पर 30 प्रतिशत उपादान की अनुमति होगी।
3. **स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन शुल्क:** भूमि के क्रय/ पट्टे पर 100 प्रतिशत छूट।
4. **विद्युत उपादान :** इकाइयां औद्योगिक दरों के अनुसार विद्युत दरों के लिए पात्र होंगी।
5. **विद्युत शुल्क:** 20 वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट।
6. **दोहरा पावर ग्रिड:** राज्य में स्थापित फ़ैब इकाइयों को दोहरा पावर ग्रिड नेटवर्क प्रदान किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु, एक ग्रिड की लागत (दोनों ग्रिड में जो कम हो) की प्रतिपूर्ति आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा तथा अन्य ग्रिड की लागत सम्बन्धित इकाई द्वारा वहन की जायेगी।
7. **जल की उपलब्धता:** सभी परियोजनाओं को अच्छी गुणवत्ता का (पेय) जल उपलब्ध कराया जायेगा।
8. **इफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना:** अधिकतम रु 1 करोड़ की सीमा सहित, ई.टी.पी. की लागत के 50 प्रतिशत तक का एकमुश्त पूंजी उपादान

9. **अवस्थापना/सामान्य सुविधा केन्द्र के विकास हेतु सहायता:** राज्य सरकार द्वारा संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी.-2.0) योजना के लाभ के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तथा ई.एम.सी.-2.0 फ्रेमवर्क आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले निवेशक को भारत सरकार की ई.एम.सी.-2.0 योजना के अनुसार अवस्थापना लागत का 50 प्रतिशत तथा सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए 25 प्रतिशत सहायता प्रदान की जायेगी।

सशक्त समिति की अनुशंसा पर राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन भूमि, विद्युत, जल, अवस्थापना, पूंजी साझाकरण, वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहनों इत्यादि सहित, फ़ैब इकाइयों के लिए केस-टू-केस आधार पर पुनः छूट पर विचार किया जा सकता है।

सेमीकण्डक्टर इकाइयों के लिए प्रोत्साहन सिलिकॉन सेमीकण्डक्टर फ़ैब, डिस्प्ले फ़ैब्रीकेशन इकाई (फ़ैब), कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेन्सर्स (एम.ई.एम.एस. सहित) फ़ैब, डिस्क्रीट सेमीकण्डक्टर फ़ैब, सेमीकण्डक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ए.टी.एम.पी.)/ आउटसोर्सर्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली और टेस्टिंग (ओ.एस.ए.टी.) सुविधा के लिए अनुमन्य होंगे।

5.11 भविष्य निधि प्रतिपूर्ति

वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के उपरान्त 1 वर्ष के निरन्तर रोजगार तथा उत्तर प्रदेश में अधिवास वाले ईएसडीएम प्रोफेशनल्स के लिए अदा की गई कुल भविष्य निधि धनराशि की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, प्रति कार्मिक रु 2000/- प्रतिमास तथा रु 1 करोड़ प्रति वर्ष प्रति इकाई की सीमा सहित 5 वर्ष तक इकाई को प्रदान किया जायेगा। यह प्रोत्साहन केवल महिला/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ ट्रांसजेन्डर/दिव्यांगजन कार्मिकों के लिए अनुमन्य है।

5.12 लीज रेन्टल्स

< रु 200 करोड़ निवेश हेतु लीज/किराये पर लिये गये औद्योगिक शेड्स/औद्योगिक भवन हेतु 5 वर्षों की अवधि के लिए लीज रेन्टल चार्ज पर 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, प्रति इकाई अधिकतम रु 25 लाख प्रति वर्ष।

5.13 लॉजिस्टिक्स उपादान

अन्तर्राष्ट्रीय स्थलों से अपने मौजूदा संयंत्रों को उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानान्तरित कर रही फर्म्स को विनिर्माण उपकरण के आयात पर, परिवहन लागत व्यय की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति रु 2 करोड़/इकाई तक

अध्याय 6 : अर्ह उत्पाद (Eligible Products)

इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों हेतु अर्ह उत्पादों की सूची अनुलग्नक-1 पर प्रस्तुत है।

अध्याय 7 : शब्दावली (Glossary)

7.1 सेमीकण्डक्टर इकाइयों

सिलिकॉन सेमीकण्डक्टर फ़ैब, डिस्प्ले फ़ैब्रीकेशन इकाई (फ़ैब), कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेन्सर्स (एम.ई.एम.एस. सहित) फ़ैब, डिस्क्रीट सेमीकण्डक्टर फ़ैब, सेमीकण्डक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ए.टी.एम.पी.)/ आउटसोर्सड सेमीकण्डक्टर असेम्बली और टेस्टिंग (ओ.एस.ए.टी.) सुविधा

7.2 इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लसटर्स (EMC)

ई.एम.सी. का तात्पर्य भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स नीति 2019 (NPE, 2019) की ई.एम.सी. 2.0 योजना के अन्तर्गत अनुमोदित ई.एम.सी. से है जो इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स डिजाइन तथा विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) क्षेत्र के संवर्धन को बढ़ावा देंगे।

ये क्लसटर्स विभिन्न इलेक्ट्रानिक्स कार्यक्षेत्र/वर्टिकल्स जैसेकि मोबाईल निर्माण, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, विद्युतीकरण, पावर इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार एवं इसी प्रकार के अन्य विभिन्न उपकरणों और उनकी पूरी श्रृंखला के लिए इलेक्ट्रानिक्स कम्पोनेन्ट्स, पार्ट्स, सब-असेम्बलीज के विनिर्माण हेतु इकाइयों को स्थापना की सुविधा प्रदान करेंगे।

7.3 बैंक/ वित्तीय संस्थान

समस्त अधिसूचित बैंक इसके अन्तर्गत आच्छादित होंगे। सभी वित्तीय संस्थान जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और जिनका नियमन उसके द्वारा किया जाता है, इसके अन्तर्गत आयेंगे।

7.4 राज्य अभिकरण

- (i.) विकास प्राधिकरण
- (ii.) आवास परिषद
- (iii.) उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम
- (iv.) सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य की अन्य संस्था

अध्याय 8 : संक्षिप्त रूप

1.	CFC	Common Facility Center
2.	CoE	Center of Excellence
3.	Cr	Crore equals to 10 million
4.	EC	Empowered Committee
5.	EMC	Electronics Manufacturing Cluster
6.	ESDM	Electronics System Design and Manufacturing
7.	FAR	Floor Area Ratio
8.	FCI	Fixed Capital Investment
9.	GDP	Gross Domestic Product
10.	GoI	Government of India
11.	IIIT	The Indian Institute of Information Technology
12.	IIM	The Indian Institutes of Management
13.	IIT	The Indian Institute of Technology
14.	INR	The Indian rupee
15.	MeitY	Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India
16.	MSME	Micro, Small, and Medium Enterprises
17.	NPE	National Policy on Electronics
18.	PIA	Project Implementing Agency
19.	PIU	Policy Implementation Unit
20.	PPP	Public-private partnership
21.	SPV	Special Purpose Vehicle

नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों हेतु अर्ह उत्पादों की सूची

List of verticals of ESDM for which incentives are available under M-SIPS	
A	Electronics Products including Nano-Electronics Products and Telecom Products:
1	Telecom products including Optical Fibre Equipment; Terrestrial Communication Equipment; Satellite Communication Equipment; IP based new generation soft-switches/ routers including L2 and L3 switches, data networking equipment — copper/ optical — consumer and carrier grades, for public and private networks; Transport systems — DWDM, SDH, PON, Cross-connects, RF over optical fibre, Carrier Ethernet, Packet Optical Transport Platform (P-OTP); Wireless technology — GSM (2G & 2.5G), CDMA, 3G, LTE & LTE Advance, Wi-Fi, WiMAX & WiMAX Advance; Microwave Radio systems 2-70 GHz, Software defined radio, Cognitive radio, Distributed antenna systems; Equipment related to security and surveillance, processing of speech, data, image, video; Customer Premises Equipment (CPE) — PBX systems, Headends, 3G Routers, VoIP gateways, Residential gateways, Access points, Routers, Broadband CPEs, Mobile phones/ Mobile handsets/ Smart Mobile phones, Set-top boxes, Modems, dongles, data card; Short Range Devices (SRD), Sensors; VSAT based systems — Broadband, Disaster management; Non-conventional energy sources, portable mechanical chargers for handsets, computers; NMS/ OSS/ BSS systems for all above — SNMP/ Openview/ CORBA; Customer care & Billing systems; Electronics products for energy management, Advanced storage batteries such as Lithium, Video Conferencing Equipment, Optical Fibres and Optical Fibre Cables, etc.

2	IT Hardware products including computers (tablets, desktops etc.), servers, peripherals like printers, faxes, storage devices monitors, Automatic Teller Machines (ATM), etc.
3	Consumer Electronics like Televisions, Digital Cameras, Camcorders, Audio Video products, electronic watches and clocks, electronic toys, wearable electronics, electronic personal care products, etc.
4	Health and Medical Electronics
5	Strategic electronics
6	Solar Photo Voltaic including thin film, polysilicon etc.
7	Light Emitting Diodes (LEDs)
8	Liquid Crystal Displays (LCDs)
9	Avionics
10	Industrial Electronic products including measuring and control equipment, energy meters etc.
11	Nano electronic products
12	e-waste processing/ recycling
13	Automotive Electronics including Anti-lock braking system, Electronic Brake Distribution, Traction Control, Brushed DC Motors, etc.
14	Agri-electronics
15	Energy conservation electronics

16	Opto-electronics
17	Bio-metric and identity devices/ RFID: Smart Card manufacturing and personalization
18	Power supplies for ESDM products
19	Consumer Appliances like Refrigerators, ACs, Fully Automatic Washing Machines, Microwave Ovens, etc.
20	Electronic product design including PCB design
21	Machine to Machine (M2M) and Internet of Things (IoT) products
22	Home Fuel Cells
23	Multi-functional electronic devices
24	Semiconductor Equipment such as Automatic Test Handler, Pick & Place Machines, Test Head Manipulator and their accessories like Test Sockets, Probe Cards, ATE Load Boards, Conversion Kits, Docking Mechanisms
25	Electronic security devices- including CCTV/ surveillance equipment, CCTV, Access Control, intruder alarms etc.
B	Intermediates
1	Nano-electronic components
2	Semiconductor wafering
3	Semiconductor chips including logic, memory and analog
4	All Assembly, Testing, Marking and Packaging of ESDM Units

5	Chip components
6	Discrete Semiconductors like Transistors, Diodes
7	Power semiconductors (including diffusion) like FETs, MOSFETs, SCRs, GTDs, IGBT etc.
8	Electromechanical Components and Mechanical Parts such as Multilayer PCBs, Transformers, Coils, Connectors, Switches, Ferrites, Micro Motors, Stepper Motors, Films, Electro-plating, small precision plastic and metal parts, tools, moulds & dies, etc.
9	Consumable and Accessories such as Mobile Phone and IT accessories- Batteries Chargers etc. PCBs, Foils, Tapes, Epoxy, Cabinets, etc.
10	All Fabrication Manufacturing facilities (Fabs) for ESDM products
11	Electro-plating, small precision plastic and metal parts, tools, moulds and dies
12	Liquid Crystal Module (LCM)
13	Organic Light Emitting Diodes (OLED)
14	Chip Modules for Smart Cards
15	Analog/ Mixed Signal Semiconductor Chips
C	Electronics Manufacturing Services (EMS)
D	Capital Equipment for electronic products
E	Raw material exclusively for electronic products
F	Remanufacturing of electronic products

PLI for Large Scale Electronics Manufacturing:

S. No.	Description of Goods
1.	Mobile Phones
2.	Specified Electronic Components
2.1	SMT components
2.2	Discrete semiconductor devices including transistors, diodes, thyristors, etc.
2.3	Passive components including resistors, capacitors, etc. for electronic applications
2.4	Printed Circuit Boards (PCB), PCB laminates, prepregs, photopolymer films, PCB printing inks
2.5	Sensors, transducers, actuators, crystals for electronic applications
2.6	System in Package (SIP)
2.7	Micro / Nano-electronic components such as Micro Electromechanical Systems (MEMS) and Nano Electromechanical Systems (NEMS)
2.8	Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) units

Production Linked Incentive Scheme (PLI) for IT Hardware:

Target Segment: The Target Segment under PLI shall include (i) Laptops (ii) Tablets (iii) All-in-One PCs and (iv) Servers.

Scheme for Promotion of manufacturing of Electronic Components and Semiconductors (SPECS)

Sl. No.	Description of Goods
1.	SMT components including LED Chips
2.	Chip Modules for Smart Cards, RFID Antenna & Labels, CoB/ System in Package
3.	Passive components including resistors, capacitors, ferrites, etc. for electronic applications
4.	Electromechanical components including transformers, inductors, coils, relays, switches, micro motors, stepper motors, BLDC Motors, Connectors, Heat Sinks, Antenna, Speakers, Microphones, etc. for electronic applications
5.	Magnetrons, Wave guides, Circulators, Couplers, Isolators, Filters, Magnets, RF Components for electronic applications
6.	Printed Circuit Boards (PCBs), PCB Laminates, Prepegs, Photopolymer films, PCB Printing Inks; Printed Flexible Electronics
7.	Sensors, Transducers, Actuators and Crystals for electronic applications
8.	Camera Modules, Vibrator motor/ ringer
9.	USB/Data Cables, HDMI Cables
10.	Capital goods for all the goods covered under SPECS
Sl. No.	Description of Goods
1.	Active Components: a. Discrete semiconductor devices including transistors, diodes, etc. b. Power semiconductors including FETs, MOSFETs, Thyristors, etc.
2.	Preform of Silica and Optical Fiber
3.	Display Assembly and Touch Panel/ Cover Glass Assembly
Sl. No.	Description of Goods
1.	Micro/Nano-electronic components such as Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) and Nano Electro Mechanical Systems (NEMS)
2.	Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) units
Sl. No.	Description of Goods
1.	Mechanics (plastic and metal parts) for electronic applications
Sl. No.	Description of Goods
1.	Compound Semiconductors such as GaN, SiC, GaAs, etc. and Silicon Photonics devices/ Integrated Circuits, Optoelectronic components
Sl. No.	Description of Goods
1.	Semiconductor Wafers

Sl. No.	Description of Goods
1.	Semiconductor Integrated Chips (ICs) including Logic [Microprocessor, Microcontrollers, Digital Signal Processors (DSP), Application Specific Integrated Circuits (ASICs), etc.]; Memory; Analog/ Mixed Signal ICs, etc.
2.	Display fabrication units including Liquid Crystal Displays (LCD), Light Emitting Diode (LED), Organic Light Emitting Diode (OLED), etc. for electronic applications

भारत सरकार के ई.एस.डी.एम, एम.एस.आई.पी., एस.पी.ई.सीएस. पी.एल.आई. योजनाओं के तहत उल्लिखित, समय-समय पर यथासंशोधित सभी उत्पादों को नीति के अन्तर्गत आच्छादित किया जायेगा।

कोई भी उत्पाद जो सूची में सम्मिलित नहीं है और जिसे जोड़े जाने के लिए विभाग द्वारा भविष्य में संस्तुति की जाती है, सशक्त समिति के अनुमोदन से जोड़ा जायेगा।

ध्यानकर्षण:

यह Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy 2020 के अंग्रेजी संस्करण का अनन्तिम हिन्दी रुपान्तरण है। अतएव विषय-वस्तु सम्बन्धी किसी विसंगति/संशय की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण में निहित विषय-वस्तु ही मान्य होगी।